PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-292342

(43)Date of publication of application: 07.11.1995

(51)Int.CI.

C09J177/06 C08G 69/42 C09J183/10

(21)Application number: 06-090131

(71)Applicant: NIPPON DENPUN KOGYO KK

NIPPON OIL & FATS CO LTD

(22)Date of filing:

27.04.1994

(72)Inventor:

AKASHI MITSURU

SEKI KOUJI

KISHIMOTO MAMORU NAGATA KAZUSHI WAKI KAZUNORI KOINUMA YASUYOSHI

(54) POLYARAMID SILOXANE BASED THERMORESISTANCE ADHESIVE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject adhesive containing a specific polyaramid siloxane resin and an organic solvent, having excellent workability during application and storage stability, excellent in heat resistance, moisture resistance, etc., and exhibiting excellent adhesivity to glass, etc.

CONSTITUTION: This adhesive is produced by compounding (A) a polyaramid siloxane resin prepared by polycondensation of an aromatic amide oligomer of formula I [X is OH, Cl, etc.; Ar1 and Ar2 each is a divalent aromatic group; (m)=1-50] with a diaminosiloxane of formula II [R1 and R2 each is a 1-5C divalent aliphatic or aromatic group; R3 and R4 each is a monovalent aliphatic or aromatic group; (n)=1-100] and containing a diaminosiloxane unit in an amount of 10-50wt.% and (B) an organic solvent (preferably dimethyl sulfoxide, etc.) preferably in the ratio of 10g of the component A against 50-500ml of the component B. Further, the preparation of the oligomer of formula I is preferably carried out by using isophthalic acid as the aromatic dicarboxylic acid.

 $XCO-\Lambda r^2 + COMH-\Lambda r^3 - NHCO+\Lambda r^2 + COX$

м, к, н°л.-к, ф; о}-к; -к, –иц.

11

1

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-292342

(43)公開日 平成7年(1995)11月7日

(51) Int.C1.8	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 9 J 177/06	JFY			
C 0 8 G 69/42	NSN			
C 0 9 J 183/10	JGF			

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 9 頁)

(21)出願番号	特顯平 6-90131	(71) 出願人 594072580
		日本澱粉工業株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)4月27日	鹿児島県鹿児島市南榮3丁目20番地
		(71) 出願人 000004341
		日本油脂株式会社
		東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
		(72)発明者 明石 満
		鹿児島県鹿児島市皇徳寺台2丁目14番6号
		(72)発明者 積 浩二
		鹿児島県鹿児島市和田町924番地 6
		(72)発明者 岸本 守
		鹿児島県鹿児島市中山町3129番地53
		(74)代理人 弁理士 酒井 一 (外1名)
		最終頁に続く
		1

(54) 【発明の名称】 ポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤

(57)【要約】

 *表わされるジアミノシロキサンとを重縮合して得られる、ジアミノシロキサン構成単位の含有量が特定のポリアラミドシロキサン樹脂と、有機溶剤とを含有するポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤。

【化1】

XCO-Ar'-(CONH-Ar'-NHCO-Ar') =-COX

【化2】

$$H_2 N - R^1 \xrightarrow{R^3} i - O \xrightarrow{\pi} i - R^2 - NH_2$$

【効果】 本発明は、操作性等に優れ、ガラス、シリコ

ーン基板等への接着性が高く、保存安定性、耐熱性、耐湿性等に優れているため、半導体素子用の接着剤、その他ガラス用の接着剤等に最適である他、半導体の層間絶縁膜、保護膜、コーティング剤、ワニス等に利用でき、しかも安価で作業性がよく、低コスト化を図ることができる。

【特許請求の範囲】

 *しくは異なる基であって、1価の脂肪族基又は芳香族基を示す。またnは1~100の整数を示す。)で表わされるジアミノシロキサンとを重縮合して得られる、ジアミノシロキサン構成単位の含有量が10~50重量%のポリアラミドシロキサン樹脂と、有機溶剤とを含有することを特徴とするポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤。

し、R³及びR⁴は、同一若* 【化1】 XCO-Ar³—(CONH-Ar²-NHCO-Ar³) _B-COX

【化2】

$$H_{2}N-R^{2} \xrightarrow{R^{2}} Si-O \xrightarrow{\pi} Si-R^{2}-NH_{2}$$

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、耐熱性、耐湿性等に優れ、且つガラス板、シリコンウエハー等に優れた接着性を示すポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤に関する。

[0002]

【従来の技術】従来よりポリイミド系樹脂及びポリアミド系樹脂は、ガラス基板、シリコンウエハー、半導体等の接着剤の他、層間絶縁膜、保護膜、コーティングワニス等のエレクトロニクス分野、または一般的なコーティング剤及びワニス等に広く利用されている。前記ポリイミド樹脂は耐熱性には優れているが、溶媒に対する溶解性が低いので、接着剤として使用する場合には、テトラカルボン酸二無水物とジアミンとを、有機溶媒中に反応させてポリアミド酸を生成させた後、ガラス等の基材に塗布し、300℃以上の髙温にて加熱脱水及び閉環させる必要がある。しかもこれらの樹脂は、ガラス、シリコンウエハ一等に対する接着性が不十分であるという欠点もある。

【0003】これらの欠点を解決するため、特開昭54 -146851号公報、特開昭58-13631号公 報、特開昭59-4623号公報及び特開昭63-77 936号公報には、シロキサン結合を導入したポリイミ ド樹脂が、また特開平5-98235号公報には、ポリイミドシロキサン樹脂を使用したフィルム状接着剤が、 更に特開平4-356534号公報には、シリコン変性 ポリイミドフィルムが提案されている。しかしながら、 前記シロキサン結合を導入したポリイミド樹脂を接着剤 として用いる場合には、乾燥後にイミド化を行うための 再加熱が必要であり、また前記フィルム状接着剤及び前 記シリコン変性ポリイミドフィルムを用いる場合には、 フィルム状の樹脂を加熱圧着して使用するため、操作性 10 に問題がある。

【0004】更に特開平2-225521号公報及び特開平3-43418号公報には、ポリアミドシロキサン樹脂が提案されている。しかしながら、特開平2-225521号公報のポリアミドシロキサン樹脂は、使用するモノマーが特殊なので、接着剤、コーティング剤として使用するにはコストがかかるという問題があり、また、特開平3-43418号公報のポリシロキサンポリアミド樹脂は、芳香環に官能基として水酸基を有しているので、接着剤として使用する場合、保存安定性に問題20が生じるおそれがある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、使用時の操作性及び保存安定性が良好で、耐熱性、耐湿性等に優れ、且つガラス、シリコンウエハー等に優れた接着性を示すポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、下記ー 般式化3(式中Xは水酸基、塩素原子又は臭素原子を示 30 し、Ar¹及びAr²は、同一若しくは異なる基であっ て、2価の芳香族残基を示す。またmは1~50の整数 を示す。)で表わされる芳香族アミドオリゴマー(以下 アミドオリゴマーAと称す)と、下記一般式化4(式中 R¹及びR²は、同一若しくは異なる基であって、炭素数 が1~5の2価の脂肪族基又は芳香族基を示し、R3及 びR⁴は、同一若しくは異なる基であって、1価の脂肪 族基又は芳香族基を示す。また n は 1 ~ 1 0 0 の整数を 示す。)で表わされるジアミノシロキサン(以下ジアミ ノシロキサンBと称す)とを重縮合して得られる、ジア 40 ミノシロキサン構成単位の含有量が10~50重量%の ポリアラミドシロキサン樹脂(以下ポリアラミドシロキ サン樹脂Cと称す)と、有機溶剤とを含有することを特 徴とするポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤が提供 される。

> [0007] [化3]

[8000]

【化4】

 $XCO-Ar^3$ -(CONH-Ar³-NHCO-Ar 4) m-COX

【0009】以下本発明を更に詳細に説明する。本発明のポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤は、特定のポリアラミドシロキサン樹脂と、有機溶剤とを含有する。 【0010】本発明において、必須成分である前配特定のポリアラミドシロキサン樹脂は、前記一般式化3で表わされるアミドオリゴマーAと、前記一般式化4で表わ 10 されるジアミノシロキサンBとを重縮合して得られる、*

*ジアミノシロキサン構成単位の含有量が特定範囲のポリアラミドシロキサン樹脂Cであり、前記一般式化3においてmが51以上、また前記一般式化4においてR¹及びR²の炭素数が6以上又はnが101以上の場合には各化合物の製造が困難である。

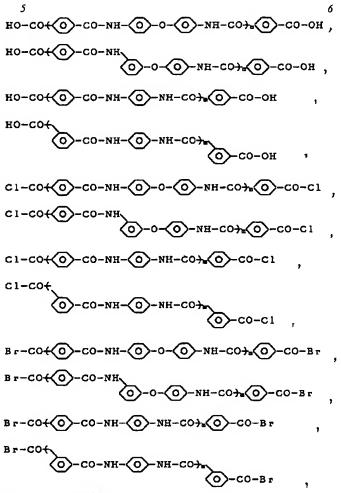
【0011】前記アミドオリゴマーAにおいて、 Ar^1 及び Ar^2 の2価の芳香族残基としては、下記構造式化5で表わされる化合物等を挙げることができる。

[0012]

【化5】

【0013】前記アミドオリゴマーAの具体例としては、下記構造式化6で表わされる化合物等を好ましく挙 30 げることができ(但し、式中mは1~50の整数を示す)、使用に際しては単独若しくは混合物として用いる

ことができる。 7 【0014】 【化6】



【0015】前記アミドオリゴマーAを調製するには、 例えば、芳香族ジカルボン酸と芳香族ジアミンとを、ジ 30 シクロヘキシルカルボジイミド等の縮合剤の存在下、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、Nーメチルー2-ピロリドン、ジメチルスル ホキシド等の非反応性溶媒中にて反応させる方法等によ り得ることができる。この際反応温度は-30~150 ℃が好ましく、特に-20~100℃が望ましい。また 反応時間は1~48時間が望ましい。

【0016】前記芳香族ジカルボン酸としては、例えば テレフタル酸、イソフタル酸、ジフェニルエーテルー 4, 4'ージカルボン酸、ジフェニルスルホン-4, 4'ージカルボン酸、ジフェニルー4,4'ージカルボ ン酸等を挙げることができ、特に安価に入手できる点か らイソフタル酸を使用することが好ましい。

【0017】前記芳香族ジアミンとしては、例えばm-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、3,4'ージアミノ ジフェニルエーテル、4, 4'ージアミノジフェニルエ ーテル、4,4'ージアミノジフェニルスルフィド、 4, 4'ージアミノジフェニルスルホン、3, 3'ージ

ジメトキシーベンジジン、ビス(p-β-アミノーt-プチルフェニル) エーテル、p-ビス (2-メチル-4 ーアミノペンチル) ベンゼン、1,5-ジアミノナフタ レン等を挙げることができ、使用に際しては単独若しく は混合物として用いることができる。

【0018】また前述の方法の他に前記アミドオリゴマ ーAを調製するには、芳香族ジカルボン酸クロリド、芳 香族ジカルボン酸ブロミド等の芳香族ジカルボン酸の反 応性誘導体と芳香族ジアミンとを、トリエチルアミン等 の酸受容体の存在下、クロロホルム中にて反応させる方 法等により得ることもできる。この際反応に発熱を伴う 40 ため、冷却しながら反応温度を零度以下に保つようにす るのが好ましい。また反応時間は0.1~20時間が好 ましい。

【0019】これらの反応を行うにあたり、前記芳香族 ジカルボン酸又はその反応性誘導体と、前記芳香族ジア ミンとの仕込みモル比は、1.01~5:1が好まし く、特に1.02~2:1が望ましい。

【0020】前記ジアミノシロキサンBにおいて、R1 及び R^2 の炭素数 $1\sim5$ の2価の脂肪族基としては、ア ルキレン基等を挙げることができ、2価の芳香族基とし メチルー4,4'ージアミノービフェニル、3,3'ー 50 ては、前述の構造式化5で表わされる化合物等を挙げる ことができる。また R^3 及び R^4 の1価の脂肪族基としては、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、アルコキシ基等を挙げることができ、1価の芳香族基としては、フェニル基等を好ましく挙げることができる。

【0021】前記ジアミノシロキサンBの具体例として*

*は、下記式化7で表わされる化合物等を挙げることができ、使用に際しては単独若しくは混合物として用いることができる。

[0022]

【化7】

$$CH_{2}$$
 CH_{3} CH_{2} CH_{2} CH_{3} CH_{2} CH_{3} CH_{3} CH_{3} CH_{3} CH_{3} CH_{3}

$$CH_3$$
 CH_3 CH_4 CH_4 CH_5 CH_5 CH_6 CH_6 CH_6 CH_6 CH_7

CH, CH,
$$H_2 N - (CH_2) + (S i - O) + (CH_2) + (CH_3) + (CH_4) +$$

$$CH_{2}$$
 CH_{3} CH_{2} CH_{2} CH_{2} CH_{2} CH_{3} CH_{3} CH_{4}

$$CH_3$$
 CH_3
 $H_2N - (CH_2) \cdot (Si - O) \cdot (CH_2) \cdot (CH_2) \cdot (CH_2) \cdot (CH_2) \cdot (CH_3) \cdot (CH_$

$$H_2N - (CH_2) \xrightarrow{\circ} (S i - O) \xrightarrow{\circ} S i - (CH_2) \xrightarrow{\circ} NH_2$$

OH

OH

$$CH_3$$
 CH_3
 $H_2N - (CH_2)_2 \cdot (Si - O)_{20} \cdot Si - (CH_2)_2 \cdot NH_2$
 $CH_2CH_2CF_3 \cdot CH_2CH_2CF_3$

【0023】前記ジアミノシロキサンBを調製するには、例えばオクタメチルサイクロテトラシロキサン等のサイクロテトラシロキサンと、1, 3-ビス(アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン等のビスアミノジシロキサンとを、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドを触媒として、80%、24 時間反応させる方法等により得ることができる。また商品名「X22-161-AS」、「X22-161-AB」(信越化学(株)製)等の市販品を用いることもできる。

【0024】前記ポリアラミドシロキサン樹脂Cを調製 50 ロロホルム中にて反応させる方法等により得ることがで

40 するには、例えば両末端に芳香族ジカルボン酸残基を有する前記アミドオリゴマーAと、前記ジアミノシロキサンBとを、ジシクロヘキシルカルボジイミド等の縮合剤存在下、N,Nージメチルホルムアミド等の非反応性溶媒中にて反応させる方法等により得ることができる。この際反応温度は-30~150℃、反応時間は1~48時間であるのが好ましい。また別の方法としては、例えば両末端に芳香族ジカルボン酸の反応性誘導体残基を有する前記アミドオリゴマーAと、前記ジアミノシロキサンBとを、トリエチルアミン等の酸受容体の存在下、ク

きる。この際反応温度は0 \mathbb{C} 以下、反応時間は $1\sim60$ 時間であるのが好ましい。

【0025】これらの重縮合反応により得られる反応混合物を、メタノール、ヘキサン等の貧溶媒に滴下又は注入して重合体を分離した後、再沈殿法等の公知の方法で精製を行うことにより、前記ポリアラミドシロキサン樹脂Cを得ることができる。

*【0026】前記得られるポリアラミドシロキサン樹脂 Cの具体例としては、下記構造式化8及び化9で表わされる化合物等を好ましく挙げることができる(但し、式 中mは1~50の整数を示す)。

10

[0027] [化8]

-HN-(CH₂)₃Si
$$+0$$
-Si)₃₈-(CH₂)₃-NH-CO $+(0)$ -CO-NH- $+(0)$ -O- $+(0)$ -NH-CO $+(0)$ -CO-NH-CO+ $+(0)$ -CO-NH

[0028]

【化9】

【0029】前記ポリアラミドシロキサン樹脂 Cの固有 粘度 (n i n h) は、0.2 d 1/g以上であるのが好ましく、特に0.4 d 1/g以上が望ましい。前記固有 粘度が0.2 d 1/g 未満の場合、重合度が低く、接着 剤としての機械的強度が不十分なので好ましくない。 尚、前記固有粘度は、N, N-ジメチルアセトアミド100m1 中に、前記ポリアラミドシロキサン樹脂 C を溶解し、30Cにて測定した値である。

【0030】前記ポリアラミドシロキサン樹脂Cは、前記アミドオリゴマーAと前記ジアミノシロキサンBとを重縮合して得られる、ジアミノシロキサン構成単位の含有量が $10\sim50$ 重量%の重合体であって、ジアミノシロキサン構成単位の下限は、ガラス等への接着性を十分とするために10重量%、好ましくは15重量%であり、また上限は耐熱性の低下を防止するために50重量%、好ましくは45重量%である。

【0031】本発明において、必須成分として含有する 有機溶媒としては、特に限定されるものではないが、例 えばN, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチル アセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチル スルホキシド等を好ましく挙げることができる。使用に 40 際しては単独若しくは混合物として用いることができる。

【0032】本発明のポリアラミドシロキサン系耐熱性接着剤において、前記ポリアラミドシロキサン樹脂Cと前記有機溶媒との配合割合は、ポリアラミドシロキサン樹脂C10gに対して有機溶媒20~1000mlが好ましく、特に50~500mlが望ましい。

【0033】本発明のポリアラミドシロキサン系耐熱性 接着剤には、本発明の特性を損なわない範囲で、前記必 領成分の他、各種添加剤を含有させることもできる。該 50 ない。

添加剤としては、例えば、基材に対する濡れ性を高める ための各種界面活性剤及びシランカップリング剤、また 接着後の強度及び耐熱性を高めるための各種架橋剤等を 挙げることができる。

【0034】本発明のポリアラミドシロキサン耐熱性接着剤を使用するには、例えば、ガラス等の基板面に塗布して被接着体を圧着させるか、基板と被接着体との間に接着剤をはさみ込んだ後、200℃以下、1時間程度、乾燥して有機溶媒を除去して硬化させる方法等があり、このような方法は、基板と被接着体とに優れた接着性を30 付与することができる。また乾燥硬化させた後は、200℃以上の温度でも接着面は安定した状態を保つことができる。

[0035]

【発明の効果】本発明は、芳香族アミドオリゴマーとジアミノシロキサンとを重縮合させて得られるポリアラミドシロキサン樹脂と、有機溶媒とを必須成分として含有し、使用に当っては、比較的低い温度で有機溶媒を除去できるので、操作性等に優れた接着剤として利用可能である。またガラス、シリコーン基板等への接着性が高く、保存安定性、耐熱性、耐湿性等に優れているため、半導体素子用の接着剤、その他ガラス用の接着剤等に最適である。更に接着剤としてだけではなく、半導体の層間絶縁膜、保護膜、コーティング剤、ワニス等の広い分野で使用することが可能であり、しかも汎用の原料を使用するため安価であり、比較的低温且つ短時間で接着するため作業性がよく、低コスト化を図ることができる。【0036】

【実施例】以下本発明を実施例及び比較例により更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0037]

【実施例1】100mlのナス型フラスコ中にて、イソ フタル酸クロリド1. 42g (7ミリモル)をクロロホ ルム10mlに溶解し、反応槽を-15℃に保ちなが 6、予めクロロホルム10mlに溶解しておいた、3, 4'ージアミノジフェニルエーテル1.2g(6ミリモ ル)、トリエチルアミン2.5ml及びトリエチルアミ ン塩酸塩1.28gを滴下した。次いで、撹拌しながら 20分間反応させた後、クロロホルム10mlに溶解し たジアミノポリジメチルシロキサン(信越化学工業

(株) 製、商品名「X22-161-AS」) 0. 9g*

ĊН

【化10】 -HN-(CHz)z\$i(0-\$i)n(CHz)z-NH-CO

[0038]

【0039】得られたポリアラミドシロキサン樹脂を、 N, N-ジメチルアセトアミドに溶解して10重量%溶 20 液を調製し、接着剤とした。この接着剤をガラス基板上 に塗布し、160℃、1時間乾燥後、溶媒のN, N-ジ メチルアセトアミドを除去し、硬化させた。得られたポ リアラミドシロキサン樹脂の膜厚は約5μmであった。 得られた塗膜にカッターナイフで幅1mm、縦横それぞ れ11本の切れ込みを入れ、10×10の基板目を作っ た。沸騰浴中に5時間浸漬前後の基板目にセロハンテー プをはりつけ、剥離試験を行った結果、剥がれた基板目

は0個であった。 [0040]

【実施例2】イソフタル酸クロリドの仕込み量を2.4 3g(12ミリモル)に、3,4'ージアミノジフェニ ルエーテルの仕込み量を2.2g(11ミリモル)に、 ジアミノポリジメチルシロキサン (信越化学工業 (株) 製、商品名「X22-161-AS」) 0. 9g (1ミ リモル)を、ジアミノポリジメチルシロキサン (信越化 学工業(株)製、商品名「X22-161-B」)3. Og (1ミリモル) に代えた以外は、実施例1と同様に 行いポリアラミドシロキサン樹脂を得た(但し、mは1 1、nは39を示す)。収量、収率、固有粘度(η i n h) 及びシロキサン含有率を表1に示す。次いで実施例 1と同様に接着剤を調製し、剥離試験を行った。結果を 表1に示す。

[0041]

【実施例3】イソフタル酸クロリド仕込み量を2.03 g (10ミリモル) に、ジアミノポリジメチルシロキサ ン(信越化学工業(株)製、商品名「X22-161-AS」) 0.9g(1ミリモル) を、ジアミノポリジメ チルシロキサン (信越化学工業 (株) 製、商品名「X2 2-161-A」) 1. 68g (1ミリモル) に代えた 50 9、nは20を示す)。収量、収率、固有粘度 (nin

* (1ミリモル) 及びトリエチルアミン 0. 5 m l を滴下 し、-15℃で1時間、更に室温で48時間反応させ た。得られた反応生成物をメタノール中に滴下し、析出 物を濾別乾燥した後、n-ヘキサンで洗浄、乾燥して、 下記構造式化10で表わされるポリアラミドシロキサン ブロック共重合体を得た(但し、式中mは6、nは10 を示す)。収量、収率、固有粘度(ηinh)及びシロ キサン含有率を表1に示す。

14

以外は、実施例1と同様に行いポリアラミドシロキサン 樹脂を得た(但し、mは9、nは20を示す)。収量、 収率、固有粘度(ninh)及びシロキサン含有率を表 1に示す。次いで実施例1と同様に接着剤を調製し、剥 離試験を行った。結果を表1に示す。

[0042]

【実施例4】イソフタル酸クロリド1、42g(7ミリ モル)を、テレフタル酸クロリド2. 43g(12ミリ モル) に、3, 4' ージアミノジフェニルエーテル1. 2g (6ミリモル) を2. 2g (11ミリモル) に、ジ アミノポリジメチルシロキサン (信越化学工業 (株) 30 製、商品名「X22-161-AS」) 0. 9g (1ミ リモル)を、ジアミノポリジメチルシロキサン (信越化 学工業(株)製、商品名「X22-161-A」)1. 68g(1ミリモル)に代えた以外は、実施例1と同様 に行いポリアラミドシロキサン樹脂を得た(但し、式中 mは11、nは20を示す)。収量、収率、固有粘度 (n i n h) 及びシロキサン含有率を表1に示す。次い で実施例1と同様に接着剤を調製し、剥離試験を行っ た。結果を表1に示す。

[0043]

【実施例5】イソフタル酸クロリドの仕込み量を2.0 3g(10ミリモル)に、3,4'-ジアミノジフェニ ルエーテル1.2g(6ミリモル)を、4,4'ージア ミノジフェニルエーテル1.80g (9ミリモル) に、 ジアミノポリジメチルシロキサン (信越化学工業 (株) 製、商品名「X22-161-AS」) O. 9g (1ミ リモル)を、ジアミノポリジメチルシロキサン(信越化 学工業(株)製、商品名「X22-161-A」)1. 68g(1ミリモル)に代えた以外は、実施例1と同様 に行いポリアラミドシロキサン樹脂を得た(但し、mは

h) 及びシロキサン含有率を表1に示す。次いで実施例 1と同様に接着剤を調製し、剥離試験を行った。結果を 表1に示す。

[0044]

【比較例1】4,4'ージアミノジフェニルエーテル1 0ミリモルを、N, N-ジメチルアセトアミド20ml に溶解し、ピロメリット酸二無水物10ミリモルを添加 した後、室温で10時間反応させた。得られたポリアミ ド酸をガラス基板に塗布し、300℃、1時間、加熱脱 ポリイミド樹脂面に、カッターナイフで実施例1と同様 の切り込みを入れ、剥離試験を行った。結果を表1に示 す。

[0045]

【比較例2】イソフタル酸クロリドの仕込み量を1.8 9g (9ミリモル) に、3, 4' ージアミノジフェニル エーテルの仕込み量を1.6g(8ミリモル)に、ジア ミノポリジメチルシロキサン (信越化学工業(株)製、 商品名「X22-161-AS」) 0. 9g(1ミリモ ル)を、1、3-ビス(3-アミノプロピル)テトラメ チルジシロキサン (チッソ (株) 製) 0. 25g (1ミ リモル) に代えた以外は、実施例1と同様に行いポリア ラミドシロキサン樹脂を得た(但し、mは8、nは1を 水した後、閉環させてポリイミド樹脂を得た。得られた 10 示す)。収量、収率、固有粘度 (ηinh) 及びシロキ サン含有率を表1に示す。次いで実施例1と同様に接着 剤を調製し、剥離試験を行った。結果を表1に示す。 [0046]

133	•	- 1
170		- 1

Г		収 量	収塞	固有粘度	シロキサン	基盤目試験で	56 RE 1 -A - 44 - 44
		(g)	(%)	(d1/g) \$	含量 (%)	沸騰水前	剥離した枚数
実	1	2.8	87.4	0.34	30	0/100	0/100
	2	5.4	70.1	0.36	4 5	0/100	0/100
施	3	3.8	66.5	0.57	3 5	0/100	0/100
ا ـ ا	4	3.6	52.5	0.49	2 9	0/100	0/100
例	_5_	3.5	61.3	0.51	2 9	0/100	0/100
比	1				_	80/100	95/100
較例	2				8	40/100	50/100

*ジメチルアセトアミド中、30℃

フロントページの続き

(72) 発明者 永田 一志 鹿児島県鹿児島市中山町3129番地53

(72) 発明者 脇 一徳

茨城県つくば市春日2-20-3

(72) 発明者 鯉沼 康美

茨城県つくば市東新井32-16